

< 2017년도 정규교육과정 일정 안내 >

과정명	월	기간(hr) (교육비)	정원	4 APR	5 MAY	6 JUN	7 JUL	8 AUG	9 SEP	10 OCT	11 NOV	12 DEM
반도체기초		5일(33hr) (₩700,000)	22	10-14 (3차)	22-26 (4차)	12-16 (5차)		21-25 (6차)	18-22 (7차)	23-27 (8차)	13-17 (9차)	11-15 (10차)
반도체실무 I		5일(30hr) (₩500,000)	40		5/29-6/2 (2차)						20-24 (3차)	
반도체실무 II		3일(22hr) (₩350,000)	20								27-29 (2차)	
평판디스플레이		4일(26hr) (₩400,000)	40	3-6 (1차)		26-29 (2차)					폐강 6-9 (3차)	
플라즈마		4일(26hr) (₩400,000)	30			12-15 (2차)			11-14 (3차)			
장비진공		4일(26hr) (₩400,000)	35	24-27 (1차)			3-6 (2차)			16-19 (3차)		
반도체장비통신		3일(20hr) (₩300,000)	30	19-21 (1차)					4-6 (2차)			4-6 (3차)
Dry Etcher		3일(20hr) (₩300,000)	25	5-7 (1차)					27-29 (2차)			
PECVD/ALD		3일(19hr) (₩300,000)	25		15-17 (1차)					10/30-11/1 (2차)		

◎ 상기의 일정은 변경될 수 있음. (Ver:2017.10.20)

◎ [고용노동부-사업주 직업능력개발훈련 지원사업]에 의해 인정 받은 교육과정으로 약 32% 지원금 환급.

< 2017년도 정규교육과정 접수기간 안내 >

안내서 (발송일)	접수기간 (확정통보일)	교육과정 및 기간	정원 (업체별최대인원)
2월 (01.13)	01.16~01.30 (01.31)	반도체기초과정 (1차)	02.20~02.24 22 (4)
3월(1) (01.25)	01.26~02.12 (02.13)	플라즈마기술과정 (1차)	03.06~03.09 30 (6)
	01.26~02.19 (02.20)	반도체기초과정 (2차)	03.13~03.17 22 (4)
3월(2) (02.10)	02.13~02.26 (02.27)	반도체실무과정 II (1차)	03.20~03.22 20 (4)
	02.13~03.05 (03.06)	반도체실무과정 I (1차)	03.27~03.31 40 (8)
4월(1) (02.24)	02.27~03.12 (03.13)	평판디스플레이과정 (1차)	04.03~04.06 40 (8)
	02.27~03.14 (03.15)	Dry Etcher기술과정 (1차)	04.05~04.07 25 (5)
	02.27~03.19 (03.20)	반도체기초과정 (3차)	04.10~04.14 22 (4)
4월(2) (03.10)	03.13~03.27 (03.28)	반도체장비통신기술과정 (1차)	04.19~04.21 30 (6)
	03.13~04.02 (04.03)	장비진공기술과정 (1차)	04.24~04.27 35 (7)
5월 (04.07)	04.10~04.23 (04.24)	PECVD/ALD기술과정 (1차)	05.15~05.17 25 (5)
	04.10~05.01 (05.02)	반도체기초과정 (4차)	05.22~05.26 22 (4)
	04.10~05.07 (05.08)	반도체실무과정 I (2차)	05.29~06.02 40 (8)
6월(1) (05.02)	05.08~05.21 (05.22)	플라즈마기술과정 (2차)	06.12~06.15 30 (6)
	05.08~05.21 (05.22)	반도체기초과정 (5차)	06.12~06.16 22 (4)
6월(2) (05.19)	05.22~06.06 (06.07)	평판디스플레이과정 (2차)	06.26~06.29 40 (8)
	05.22~06.11 (06.12)	장비진공기술과정 (2차)	07.03~07.06 35 (7)
8월 (07.14)	07.17~07.30 (07.31)	반도체기초과정 (6차)	08.21~08.25 22 (4)
9월(1) (07.28)	07.31~08.15 (08.16)	반도체장비통신기술과정 (2차)	09.04~09.06 30 (6)
	07.31~08.20 (08.21)	플라즈마기술과정 (3차)	09.11~09.14 30 (6)
9월(2) (08.11)	08.16~08.29 (08.30)	반도체기초과정 (7차)	09.18~09.22 22 (4)
	08.16~09.03 (09.04)	Dry Etcher기술과정 (2차)	09.27~09.29 25 (5)
10월 (09.08)	09.11~09.24 (09.25)	장비진공기술과정 (3차)	10.16~10.19 35 (7)
	09.11~09.26 (09.27)	반도체기초과정 (8차)	10.23~10.27 22 (4)
	09.11~10.09 (10.10)	PECVD/ALD기술과정 (2차)	10.30~11.01 25 (5)
11월(1) (09.27)	09.28~10.15 (10.16)	~~평판디스플레이과정 (3차)~~	<del>11.06~11.09</del> 정원미달로 폐강 40 (8)
	09.28~10.22 (10.23)	반도체기초과정 (9차)	11.13~11.17 22 (4)
11월(2) (10.13)	10.16~10.29 (10.30)	반도체실무과정 I (3차)	11.20~11.24 40 (8)
	10.16~11.05 (11.06)	반도체실무과정 II (2차)	11.27~11.29 20 (4)
12월 (10.27)	10.30~11.12 (11.13)	반도체장비통신기술과정 (3차)	12.04~12.06 30 (6)
	10.30~11.19 (11.20)	반도체기초과정 (10차)	12.11~12.15 22 (4)

◎ 접수기간은 교육 실시 5주전부터 3주전까지이고, 선착순으로 이루어집니다.

◎ 과정별 정원에 따라 업체별 최대수강인원이 제한됩니다.